2026-2031年全球及中国人工智能芯片（AI芯片）行业发展前景展望与投资战略规划分析报告

目 录

CONTENTS

——综述篇——
第1章：AI芯片综述/产业画像/研究说明
1.1 AI芯片行业综述
1.1.1 AI芯片的界定
1、AI芯片的定义
2、AI芯片的特征
1.1.2 AI芯片的发展
1.1.3 AI芯片所处行业
1.1.4 AI芯片行业监管
1.1.5 AI芯片行业标准
1.2 AI芯片产业画像
1.2.1 AI芯片产业链结构图
1.2.2 AI芯片产业链全景图
1.2.3 AI芯片产业区域热力
1.3 AI芯片研究说明
1.3.1 本报告研究范围界定
1.3.2 本报告专业术语说明
1.3.3 本报告权威数据来源
1.3.4 研究方法及统计标准
——现状篇——
第2章：全球AI芯片行业发展现状分析
2.1 全球AI芯片行业发展历程
2.2 全球AI芯片市场规模体量
2.3 全球AI芯片市场供需现状
2.3.1 全球AI芯片市场发展现状
2.3.2 全球AI芯片市场需求分析
1、算力对芯片的需求分析
2、AI服务器对芯片的需求分析
2.3.3 全球AI芯片下游应用结构
2.4 全球AI芯片企业及竞争力
2.4.1 全球AI芯片企业及其产品
2.4.2 全球AI芯片市场竞争格局
2.4.3 全球AI芯片市场集中度
2.4.4 全球AI芯片投融资与并购
2.5 全球AI芯片区域发展格局及重点区域市场
2.5.1 全球AI芯片区域发展格局
2.5.2 重点区域AI芯片市场概况——美国
1、发展综述
2、企业规模
3、发展现状
2.5.3 重点区域AI芯片市场概况——韩国
1、发展综述
2、企业规模
3、发展现状
4、趋势前景
2.5.4 重点区域AI芯片市场概况——日本
1、发展综述
2、企业规模
3、发展现状

4、趋势前景
2.5.5 国外AI芯片发展经验借鉴
2.6 全球AI芯片市场前景预测
2.7 全球AI芯片发展趋势洞悉
第3章：中国AI芯片行业发展现状分析
3.1 中国AI芯片行业发展历程
3.2 中国AI芯片市场主体类型
3.2.1 AI芯片市场参与者类型
3.2.2 AI芯片企业入场方式
3.3 中国AI芯片研发经营模式
3.3.1 中国AI芯片研发模式
1、企业自主研发模式
2、产学研合作模式
3、产业链协同合作模式
4、政府支持引导模式
3.3.2 中国AI芯片经营模式
1、IDM模式（Integrated Device Manufacturer，集成设备制造商）
2、Fabless模式（无厂半导体设计公司）
3、Foundry模式（代工厂）
3.4 中国AI芯片晶圆制造/封测
3.4.1 AI芯片晶圆需求特征
3.4.2 AI芯片晶圆制造产能汇总
3.4.3 AI芯片晶圆封测产能汇总
3.5 中国AI芯片企业/布局产品
3.6 中国AI芯片供给情况
3.6.1 中国AI芯片出货量
3.6.2 中国AI芯片生产情况
3.7 中国AI芯片需求情况
3.7.1 中国AI加速服务器市场规模
3.7.2 中国AI芯片销售渠道分析
3.7.3 中国AI芯片市场需求特征
3.7.4 中国AI芯片主要企业销量
3.7.5 中国AI芯片市场价格水平
3.8 中国AI芯片市场规模体量
3.9 中国AI芯片企业盈利水平
3.10 中国AI芯片行业发展痛点
第4章：中国AI芯片市场竞争及投融资
4.1 中国AI芯片行业竞争态势
4.1.1 中国AI芯片企业成功关键因素（KSF）
4.1.2 中国AI芯片行业竞争者入场进程
4.2 中国AI芯片行业竞争强度
4.2.1 中国AI芯片现有竞争者的竞争程度
4.2.2 中国AI芯片潜在竞争者的进入威胁
4.3 中国AI芯片企业竞争格局
4.3.1 中国AI芯片市场竞争梯队
4.3.2 中国AI芯片企业市场排名
4.3.3 中国AI芯片行业市场份额
4.4 中国AI芯片企业融资/IPO
4.4.1 中国AI芯片企业融资渠道
4.4.2 中国AI芯片企业融资事件
4.4.3 中国AI芯片企业融资规模
4.4.4 中国AI芯片企业IPO动态
1、中国AI芯片企业IPO情况
2、中国AI芯片行业企业上市失败情况
4.5 中国AI芯片企业投资/并购
4.5.1 中国AI芯片行业兼并与重组事件汇总
4.5.2 中国AI芯片行业兼并与重组类型及动因
4.5.3 中国AI芯片行业兼并与重组趋势预判
4.6 AI芯片外企在华布局现状

4.6.1 AI芯片外企在华布局现状
4.6.2 AI芯片外企在华市场份额
4.7 中国AI芯片国产替代现状
4.7.1 中国AI芯片亟待技术突围与国产替代的产品/环节
4.7.2 中国AI芯片国产化进程
4.7.3 中国AI芯片细分赛道国产替代空间
第5章：中国AI芯片技术进展及供应链
5.1 AI芯片技术/进入壁垒
5.1.1 AI芯片核心竞争力/护城河
5.1.2 AI芯片进入壁垒
1、技术壁垒
2、资金壁垒
3、品牌壁垒
4、准入壁垒
4、用户协同与客户渠道壁垒
5.2 AI芯片人才/基础研发
5.2.1 AI芯片技术研发投入
5.2.2 AI芯片专利申请状况/热门技术
1、专利数量
2、热门技术
3、主要机构
5.2.3 AI芯片技术研发方向/未来重点
5.3 AI芯片工艺/关键技术
5.3.1 AI芯片技术路线全景
5.3.2 AI芯片共性关键技术
1、AI芯片行业关键技术描述
（1）GPU
（2）FPGA
（3）ASIC
（4）类脑芯片
2、中国AI芯片行业关键技术发展
5.3.3 AI芯片一般工艺流程
5.4 AI芯片设计/成本结构
5.4.1 AI芯片IC设计
5.4.2 AI芯片成本结构分析
5.4.3 AI芯片价格传导机制
5.4.4 AI芯片产业价值链图
5.5 AI芯片原材料
5.5.1 AI芯片原材料概述
5.5.2 AI芯片原材料——半导体材料
1、概述
2、市场概况
3、供应商格局
5.5.3 AI芯片原材料——半导体硅片
1、概述
2、市场概况
3、供应商格局
5.5.4 AI芯片原材料——光刻胶
1、概述
2、市场概况
3、供应商格局
5.5.5 AI芯片原材料——CMP抛光液
1、概述
2、市场概况
3、供应商格局
5.5.6 中国AI芯片原材料发展趋势
5.6 AI芯片关键工具
5.6.1 AI芯片——IP核
5.6.2 AI芯片——EDA软件

5.7 AI芯片生产设备
5.7.1 AI芯片生产设备概述
5.7.2 AI芯片生产设备国产化进程
5.7.3 AI芯片生产设备——半导体设备
1、半导体设备市场规模
2、中国光刻机市场分析
3、中国刻蚀设备市场分析
4、中国薄膜沉积设备市场分析
5、中国AI加速芯片核心设备发展趋势
5.8 配套产业布局对AI芯片行业发展的影响总结
第6章：中国AI芯片细分市场发展分析
6.1 AI芯片行业细分市场概况
6.1.1 AI芯片产品综合对比
1、不同技术架构AI芯片对比
2、训练芯片和推断芯片对比
3、云端、边缘端和终端芯片
6.1.2 AI芯片细分市场结构
6.2 AI芯片细分市场：CPU（底层核心算力芯片）
6.2.1 CPU概述
6.2.2 CPU市场概况
6.2.3 CPU竞争格局
6.2.4 CPU发展趋势
6.3 AI芯片细分市场：GPU（最常用）
6.3.1 GPU加速卡概述
6.3.2 GPU加速卡市场概况
6.3.3 GPU加速卡竞争格局
6.3.4 GPU加速卡发展趋势
6.4 AI芯片细分市场：FPGA（可编程）
6.4.1 FPGA加速卡概述
6.4.2 FPGA加速卡市场概况
6.4.3 FPGA加速卡竞争格局
6.4.4 FPGA加速卡发展趋势
6.5 AI芯片细分市场：ASIC（专用）
6.5.1 ASIC加速卡概述
6.5.2 ASIC加速卡市场概况
6.5.3 ASIC加速卡竞争格局
6.5.4 ASIC加速卡发展趋势
6.6 AI芯片细分市场：类脑（NPU）芯片
6.6.1 类脑（NPU）芯片概述
6.6.2 类脑（NPU）芯片市场概况
6.6.3 类脑（NPU）芯片竞争格局
6.6.4 类脑（NPU）芯片发展趋势
6.7 AI芯片细分市场战略地位分析
第7章：中国AI芯片细分应用市场分析
7.1 AI芯片应用场景及行业分布
7.2 AI芯片细分应用：自动驾驶
7.2.1 自动驾驶领域AI芯片应用概述
7.2.2 中国自动驾驶市场发展现状
1、智能汽车销量
2、智能汽车渗透率
7.2.3 中国自动驾驶领域AI芯片应用情况
7.2.4 中国自动驾驶领域AI芯片应用市场潜力
7.3 AI芯片细分应用：智慧安防
7.3.1 智慧安防领域AI芯片应用概述
7.3.2 中国智慧安防市场发展现状
7.3.3 中国智慧安防领域AI芯片应用情况
7.3.4 中国智慧安防领域AI芯片应用市场潜力
7.4 AI芯片细分应用：智能家居
7.4.1 智能家居领域AI芯片应用概述

7.4.2 中国智能家居市场发展现状
1、智能家居产品结构
2、智能家居市场现状
7.4.3 中国智能家居领域AI芯片应用情况
1、语音芯片应用
2、家庭安防芯片应用
7.4.4 中国智能家居领域AI芯片应用市场潜力
7.5 AI芯片细分应用：消费电子
7.5.1 消费电子领域AI芯片应用概述
7.5.2 中国消费电子市场发展现状
1、消费电子市场规模
2、消费电子竞争格局
7.5.3 中国消费电子领域AI芯片应用情况
7.5.4 中国消费电子领域AI芯片应用市场潜力
7.6 AI芯片细分应用：机器人
7.6.1 机器人领域AI芯片应用概述
7.6.2 中国机器人市场发展现状
7.6.3 中国机器人领域AI芯片应用情况
7.6.4 中国机器人领域AI芯片应用市场潜力
7.7 中国AI芯片行业细分应用市场战略地位分析
第8章：全球及中国AI芯片企业案例解析
8.1 全球及中国AI芯片主要企业布局梳理
8.2 全球AI芯片主要企业布局案例分析
8.2.1 美国英伟达公司（NVIDIA）
1、企业基本信息
2、企业经营状况
3、企业业务架构
4、企业人工智能芯片业务布局
5、企业AI芯片业务销售&在华布局
（1）销售网络布局
（2）在华布局
8.2.2 美国英特尔公司（Intel）
1、企业基本信息
2、企业经营状况
3、企业业务架构
4、企业AI芯片业务详情介绍
5、企业AI芯片业务销售&在华布局
（1）销售网络布局
（2）在华布局
8.2.3 美国高通公司（Qualcomm）
1、企业基本信息
2、经营效益分析
3、企业业务结构
4、企业AI芯片业务介绍
5、企业AI芯片业务销售&在华布局
8.3 中国AI芯片主要企业布局案例分析
8.3.1 中科寒武纪科技股份有限公司
1、企业发展历程&基本信息
（1）企业发展历程
（2）企业基本信息
（3）企业股权结构
2、企业业务架构&经营情况
（1）企业整体业务架构
（2）企业整体经营情况
3、企业AI芯片业务布局详情
4、企业AI芯片业务布局规划&新动向
（1）企业AI芯片业务科研投入及创新成果追踪
（2）企业AI芯片业务融资及兼并重组动态追踪
（3）企业AI芯片业务相关战略布局动态追踪

5、企业AI芯片业务布局优劣势
8.3.2 北京地平线机器人技术研发有限公司
1、企业发展历程&基本信息
（1）企业发展历程
（2）企业基本信息
（3）企业股权结构
2、企业经营情况
3、企业AI芯片业务布局详情
4、企业AI芯片业务布局规划&新动向
（1）企业融资及兼并重组动态追踪
（2）企业AI芯片业务相关战略布局动态追踪
5、企业AI芯片业务布局优劣势
8.3.3 北京四维图新科技股份有限公司
1、企业发展历程&基本信息
（1）企业发展历程
（2）企业基本信息
（3）企业股权结构
2、企业业务架构&经营情况
（1）企业整体业务架构
（2）企业整体经营情况
3、企业AI芯片业务布局详情
4、企业AI芯片业务布局规划&新动向
（1）企业科研投入及创新成果追踪
（2）企业AI芯片业务相关战略布局动态追踪
5、企业AI芯片业务布局优劣势
8.3.4 深圳市海思半导体有限公司
1、企业发展历程&基本信息
（1）企业发展历程
（2）企业基本信息
（3）企业股权结构
2、企业业务架构&经营情况
（1）企业整体业务架构
（2）企业整体经营情况
3、企业AI芯片业务布局详情
4、企业AI芯片业务布局规划&新动向
（1）企业科研投入及创新成果追踪
（2）企业AI芯片业务相关战略布局动态追踪
5、企业AI芯片业务布局优劣势
8.3.5 龙芯中科技术股份有限公司
1、企业发展历程&基本信息
（1）企业发展历程
（2）企业基本信息
（3）企业股权结构
2、企业业务架构&经营情况
（1）企业整体业务架构
（2）企业整体经营情况
3、企业AI芯片业务布局详情
（1）企业AI芯片产品类型
（2）企业芯片产销情况
4、企业AI芯片业务布局规划&新动向
（1）企业科研投入及创新成果追踪
（2）企业AI芯片业务相关战略布局动态追踪
5、企业AI芯片业务布局优劣势
8.3.6 紫光展锐（上海）科技有限公司
1、企业基本信息
（1）企业基本信息
（2）企业股权结构
2、企业业务架构&经营情况
（1）企业整体业务架构

（2）企业整体经营情况
3、企业AI芯片业务布局详情
4、企业AI芯片业务布局规划&新动向
（1）企业融资及兼并重组动态追踪
（2）企业AI芯片业务相关战略布局动态追踪
5、企业AI芯片业务布局优劣势
8.3.7 平头哥半导体有限公司
1、企业基本信息
（1）企业基本信息
（2）企业股权结构
2、企业业务架构&经营情况
（1）企业整体业务架构
（2）企业整体经营情况
3、企业AI芯片业务布局详情
（1）企业AI芯片产品类型
（2）企业AI芯片应用领域
4、企业AI芯片业务布局规划&新动向
5、企业AI芯片业务布局优劣势
8.3.8 深圳云天励飞技术股份有限公司
1、企业发展历程&基本信息
（1）企业发展历程
（2）企业基本信息
（3）企业股权结构
2、企业业务架构&经营情况
（1）企业整体业务架构
（2）企业整体经营情况
3、企业AI芯片业务布局详情
（1）企业AI芯片业务布局
（2）企业AI芯片业务销售区域布局
4、企业AI芯片业务布局规划&新动向
（1）企业科研投入及创新成果追踪
（2）企业AI芯片业务相关战略布局动态追踪
5、企业AI芯片业务布局优劣势
8.3.9 深圳鲲云信息科技有限公司
1、企业发展历程&基本信息
（1）企业发展历程
（2）企业基本信息
（3）企业股权结构
2、企业业务架构&经营情况
（1）企业整体业务架构
（2）企业整体经营情况
3、企业AI芯片业务布局详情
4、企业AI芯片业务布局规划&新动向
（1）企业融资及兼并重组动态追踪
（2）企业AI芯片业务相关战略布局动态追踪
5、企业AI芯片业务布局优劣势
8.3.10 北京灵汐科技有限公司
1、企业发展历程&基本信息
（1）企业发展历程
（2）企业基本信息
（3）企业股权结构
2、企业业务架构&经营情况
（1）企业整体业务架构
（2）企业整体经营情况
3、企业AI芯片业务布局详情
4、企业AI芯片业务布局规划&新动向
（1）企业科研投入及创新成果追踪
（2）企业AI芯片业务相关战略布局动态追踪
5、企业AI芯片业务布局优劣势

——展望篇——
第9章：中国AI芯片政策环境及发展潜力
9.1 AI芯片行业政策汇总解读
9.1.1 中国AI芯片行业政策汇总
9.1.2 中国AI芯片重点政策解读
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》解读
2、《新一代人工智能发展规划》解读
9.1.3 各省市AI芯片政策规划汇总
9.1.4 AI芯片行业政策环境总结
9.2 AI芯片行业PEST环境分析
9.2.1 AI芯片行业技术环境总结
9.2.2 AI芯片行业经济环境分析
1、中国GDP及增长情况
2、中国三次产业结构
3、中国固定资产投资情况
4、中国AI芯片发展与宏观经济相关性分析
9.2.3 AI芯片行业社会环境分析
1、人口规模
2、中国人口结构
（1）年龄结构/中国人口老龄化程度
（2）中国人口性别结构
3、中国城镇化水平变化
（1）中国城镇化现状
（2）中国城镇化趋势展望
4、中国居民人均可支配收入
5、中国电子信息产业增速
6、社会环境对AI芯片行业发展的影响总结
9.3 AI芯片行业PEST分析图
9.4 AI芯片行业SWOT分析图
9.5 AI芯片行业发展潜力评估
第10章：中国AI芯片前景预测及发展趋势
10.1 AI芯片行业未来关键增长点
10.1.1 应用场景的不断拓展
10.1.2 技术创新和制程进步
10.1.3 产业协同合作加强
10.1.4 政策支持力度加大
10.1.5 国产替代进程加快
10.2 AI芯片行业发展前景预测
10.3 AI芯片行业发展趋势洞悉
10.3.1 技术创新趋势
10.3.2 细分市场趋势
10.3.3 市场竞争趋势
10.3.4 市场供需趋势
第11章：中国AI芯片行业投资机会及建议
11.1 AI芯片行业投资风险预警
11.1.1 AI芯片行业投资风险预警
11.1.2 AI芯片行业投资风险应对
11.2 AI芯片行业投资机会分析
11.2.1 AI芯片产业链薄弱环节投资机会
1、半导体设备
2、半导体材料
3、先进封装技术
11.2.2 AI芯片行业细分领域投资机会
1、云端应用芯片
2、边缘端应用芯片
11.2.3 AI芯片行业区域市场投资机会
11.2.4 AI芯片产业空白点投资机会
1、量子计算

2、类脑计算
11.3 AI芯片行业投资价值评估
11.4 AI芯片行业投资策略建议
11.4.1 关注技术研发能力强的企业
11.4.2 重视产业链协同发展的投资机会
11.4.3 关注国家政策支持的方向
11.4.4 分散投资风险
11.5 AI芯片行业可持续发展建议
11.5.1 技术创新方面
11.5.2 人才培养方面
11.5.3 产业协同方面

图表目录

图表1：人工智能与深度学习的关系
图表2：人工智能芯片与传统芯片区别对比
图表3：人工智能与半导体芯片的发展路径对照
图表4：人工智能芯片不同分类情况
图表5：AI芯片所处行业
图表6：中国AI芯片监管体系建设
图表7：中国AI芯片监管组织机构
图表8：中国AI相关标准体系建设（单位：项）
图表9：中国AI相关现行标准汇总
图表10：AI芯片产业链结构梳理
图表11：AI芯片产业链生态图谱
图表12：AI芯片产业链区域热力图
图表13：本报告研究范围界定
图表14：本报告专业术语说明
图表15：本报告权威数据来源
图表16：本报告研究统计方法
图表17：全球AI芯片行业发展历程
图表18：2022-2025年全球AI芯片行业市场规模体量（单位：亿美元）
图表19：全球AI芯片行业发展概述
图表20：2021-2025年全球计算设备算力规模（单位：EFlops）
图表21：2022-2025年全球基础设施算力规模（单位：EFlops）
图表22：2021-2025年全球AI服务器出货量及增速（单位：万台，%）
图表23：2025年全球AI芯片下游应用结构（单位：）
图表24：全球AI芯片行业部分供应商市场对比
图表25：全球AI芯片主要企业产品对比分析
图表26：全球AI加速芯片市场集中度
图表27：截至2025年全球AI芯片投融资与并购
图表28：2025年全球各国人工智能创新指数得分与排名（单位：分）
图表29：全球人工智能芯片行业区域格局
图表30：2025年美国代表性AI芯片企业营收规模情况（单位：亿美元）
图表31：美国主要AI芯片企业发展情况
图表32：2019-2025年韩国芯片及半导体行业市场规模（单位：亿美元，%）
图表33：韩国AI芯片行业企业规模描述
图表34：韩国AI芯片行业发展“三步走”
图表35：国外AI芯片发展经验借鉴
图表36：2026-2031年全球AI芯片行业市场规模预测（单位：亿美元）
图表37：全球AI芯片发展趋势洞悉
图表38：中国AI芯片行业发展历程
图表39：中国AI芯片市场参与者类型
图表40：中国AI芯片行业企业入场方式分析
图表41：AI芯片晶圆需求特征
图表42：截至2025年中国内地12寸晶圆产能汇总

图表43：截至2025年中国内地12寸晶圆已建成非主要产线统计
图表44：截至2025年中国内地12寸晶圆级封装产线统计
图表45：中国AI芯片企业产品布局
图表46：2021-2025年中国AI加速芯片出货量（单位：万张）
图表47：2021-2025年中国AI芯片行业代表性企业产品生产情况（单位：万片，万颗）
图表48：2021-2025年中国AI芯片行业代表性企业产品产量增速变动（单位：%）
图表49：2021-2025年中国AI加速服务器市场规模（单位：亿美元）
图表50：中国AI芯片销售渠道分析
图表51：中国AI芯片市场需求特征
图表52：2021-2025年中国AI芯片行业代表性企业产品销量情况（单位：万片，万颗，亿颗）
图表53：2021-2025年中国AI芯片行业代表性企业产品销量增速变动（单位：%）
图表54：英伟达部分AI芯片产品价格
图表55：中国AI芯片行业代表性企业芯片价格（单位：%）
图表56：2019-2025年中国AI芯片行业市场规模体量（单位：亿元）
图表57：2020-2025年中国AI芯片主要企业销售毛利率（单位：%）
图表58：2020-2025年中国AI芯片主要企业销售净利率（单位：%）
图表59：中国AI芯片行业发展痛点
图表60：中国AI芯片企业成功关键因素（KSF）
图表61：中国代表性AI芯片企业成功关键因素分析
图表62：中国AI芯片行业竞争者入场进程（单位：亿元）
图表63：中国AI芯片现有竞争者的竞争程度
图表64：中国AI芯片潜在竞争者的进入威胁
图表65：中国AI芯片行业企业竞争梯队
图表66：中国AI芯片行业企业TOP10
图表67：中国AI芯片行业TOP10企业概况
图表68：中国AI加速芯片市场份额（单位：%）
图表69：AI芯片行业资金来源汇总
图表70：2025年中国AI芯片企业融资事件汇总
图表71：2015-2025年中国AI芯片行业融资事件交易数量及金额统计（单位：亿元，件）
图表72：截至2025年中国AI芯片行业企业上市情况
图表73：截至2025年中国AI芯片行业企业上市失败情况
图表74：2018-2025年中国AI芯片行业兼并与重组事件汇总
图表75：AI芯片行业投资兼并与重组方式及投资动因
图表76：AI芯片主要外企在华布局现状
图表77：2021-2025年中国AI加速芯片行业外企在华市场份额（单位：%）
图表78：中国AI芯片亟待技术突围与国产替代的产品/环节
图表79：中国AI芯片国产化进程
图表80：中国AI芯片细分赛道国产替代空间分析
图表81：AI芯片市场核心竞争力分析
图表82：AI芯片准入壁垒分析
图表83：2022-2025年中国AI芯片代表性企业研发投入情况（单位：亿美元，%）
图表84：2014-2025年中国AI芯片相关专利申请及公开数量情况（单位：项）
图表85：截至2025年中国AI芯片相关热门技术TOP10分布情况（单位：项）
图表86：截至2025年中国AI芯片相关专利申请数量TOP10申请人情况（单位：项）
图表87：AI芯片技术研发方向/未来重点
图表88：AI芯片技术路线性能对比
图表89：GPU硬件技术
图表90：FPGA结构图
图表91：芯片制造流程
图表92：2025年全球十大IC设计公司营收情况（单位：亿美元）
图表93：中国AI芯片成本结构
图表94：不同制程芯片工艺设计成本（单位：百万美元）
图表95：中国AI芯片价格传导机制分析
图表96：AI芯片产业链各环节毛利率水平分析（单位：%）
图表97：半导体前端制造材料分类及主要用途
图表98：半导体后端封装材料分类及主要用途
图表99：2015-2025年中国半导体材料市场规模（单位：亿美元）
图表100：中国半导体材料各细分领域代表企业
图表101：半导体硅片分类情况（单位：毫米、微米、平方厘米、克、英寸）

图表102：半导体硅片分类情况（单位：毫米、微米、平方厘米、克、英寸）
图表103：2018-2025年中国半导体硅片市场规模（单位：亿美元）
图表104：2025年中国半导体硅片国产化率（单位：%）
图表105：中国半导体硅片竞争梯队
图表106：2021-2025年中国光刻胶市场规模及测算（单位：亿元）
图表107：中国半导体光刻胶行业国产化情况（单位：%）
图表108：中国光刻胶行业市场竞争格局
图表109：CMP的原理与技术应用
图表110：CMP工艺主要技术环节
图表111：2021-2025年全球及中国抛光材料规模情况（单位：%，亿美元）
图表112：中国抛光材料国产化率（单位：%）
图表113：中国半导体CMP材料（抛光液/垫）行业市场竞争梯队分析
图表114：全球AI芯片行业原材料市场趋势
图表115：中国芯片IP设计的企业及发展情况
图表116：中国EDA市场主要供给企业产品及特点介绍
图表117：中国公司所需EDA软件基本情况
图表118：半导体设备在芯片制造产业链中的位置及范围
图表119：半导体设备的分类
图表120：2025年中国半导体设备行业细分领域国产化替代情况（单位：%）
略·····完整目录请咨询客服

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：https://bg.qianzhan.com/

我们会竭诚为您服务！